FED

Wir verbinden

Großer Zuspruch auf die 31. FED-Konferenz im September: volles Haus im Augsburger Kongress am Park erwartet

Nach der erfolgreichen Veranstaltung im September 2022 in Potsdam mit 350 Teilnehmern liegt die Messlatte für die diesjährige 31. FED-Konferenz am 20. und 21. September in Augsburg sehr hoch. Dass die diesjährige Veranstaltung, die erstmals in Augsburg stattfindet, an den Erfolg anknüpfen kann, ist nicht unrealistisch. „Der Stand der Anmeldungen lag Ende Juli 25 Prozent über dem Vorjahr“, berichtet FED-Geschäftsführer Christoph Bornhorn. Zudem waren schon im Juni alle 44 Plätze in der begleitenden Ausstellung von PCB-Designdienstleitern, Leiterplattenexperten, EMS-Firmen, Software-Anbietern und Zulieferern für die Elektronikfertigung ausgebucht.

Dieter Müller, Vorstandsvorsitzender des FED, eröffnet am 20. September die 31. FED-Konferenz in Augsburg

Jeder Konferenztag startet mit zwei mitreißenden Keynotes und eine bunte Abendveranstaltung nach dem ersten Konferenztag steht ebenfalls auf dem Programm. In 44 Fachvorträgen und zwei Expertenrunden zeigen und diskutieren Fachleute Lösungen, um unsere Designs, Produkte und Industrie besser, resilienter und nachhaltiger zu machen.

Wer mag, kann schon am Vortag, dem 19. September von 15:30 bis 17:00 Uhr den Showroom des KI-Produktionsnetzwerks an der Universität Augsburg besuchen. Interaktive Exponate demonstrieren die Funktionsweisen und Möglichkeiten von KI in der Produktion und Arbeit in der Industrie 4.0, zum Beispiel Modelle zur Veranschaulichung von Datenkreisläufen und digitalen Zwillingen sowie einen Demonstrator für die Zustandsüberwachung von Getrieben. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung erforderlich. Alle Angebote der FED-Konferenz, den Zeitplan sowie das Rahmenprogramm gibt es online unter fed-konferenz.de und als App für’s Smartphone.

Neue Mitstreiter in den FED-Regionalgruppen: Andreas Klinger verstärkt das Team Hamburg

Die Mitglieder der FED-Regionalgruppe Hamburg haben Andreas Klinger einstimmig zum Leiter der Regionalgruppe Hamburg gewählt. Der Business Development Manager bei der KATEK-Tochter beflex electronic in Hamburg verstärkt das bisherige Duo Martin Wedel und Jan-Henryk Serzisko, die beide bei MacDermid Alpha Electronics Solutions tätig sind.

Die Leiter der FED-Regionalgruppe Hamburg (v.l.n.r.): Martin Wedel, Jan-Henryk Serzisko, beide MacDermid Alpha Electronics Solutions und Andreas Klinger, beflex electronic

„Ich freue mich besonders auf das Networking, neue Leute kennenzulernen und mich mit ihnen auszutauschen. Außerdem mag ich es, neue Dinge über Unternehmen in der Elektronikbranche zu erfahren. Auf diese Weise lerne ich auch neue Technologien kennen und erweitere mein eigenes Know-how. Man lernt nie aus, und ich denke, dass meine Arbeit beim FED mir helfen wird, noch mehr Kontakte zu knüpfen und Wissen und Erfahrungen zu sammeln. Es ist mir sehr wichtig, den Mitgliedern neue, interessante Inhalte zu bieten und viele Mitstreiter für die Projekte des FED zu begeistern“, sagte der neue Regionalgruppenleiter über seine Motive und Ziele im FED mitzuwirken. FED-Beirat, Vorstand und Geschäftsstelle heißen Andreas Klinger herzlich im Team willkommen und wünschen viel Erfolg und Freude beim neuen Ehrenamt.

Übrigens: Für die Regionalgruppenleitung Berlin, Hannover, Stuttgart, Schweiz und Jena werden noch Mitstreiter gesucht. Die Regionalgruppen des FED sind die kleinsten Einheiten im FED für den kollegialen Meinungs- und Gedankenaustausch. Die zwölf Regionalgruppen sind nach Städten benannt: Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Berlin, Dresden, Jena, München, Nürnberg sowie den beiden Alpenrepubliken Österreich und Schweiz. Zwei oder auch drei Regionalgruppenleiter organisieren, unterstützt vom Team in der Geschäftsstelle, die Verbandsarbeit vor Ort und sind die Ansprechpartner für Mitglieder in der Region.

Sieben „Goldene ZED-Zertifikate“ für Leiterlatten- und Baugruppendesigner

Im Juli konnte der FED-Vorstand sieben goldene Abschlusszertifikate verleihen.

- Markus Freund, Technische Universität Chemnitz
- Benedikt Graf, GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple
- Kevin Lott, Atlas Elektronik GmbH
- Stephan Plischke, Funkwerk Systems
- Tobias Schaur, GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple
- Kevin Standhartinger, Atlas Elektronik GmbH
- Matthias Wenger, GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple

Das goldene Zertifikat adelt 72 Leiterplatten- und Baugruppendesigner

Sie gehören zu 72 Leiterplatten- und Baugruppendesignern, die alle vier Module Leiterplatten- und Baugruppendesign von den Grundkenntnissen bis zum Spezialwissen absolviert haben. Das goldene Zertifikat berechtigt, den Berufstitel „Zertifizierter Elektronik-Designer ZED“ zu tragen.

Die vierstufige ZED-Ausbildung ist einmalig in Europa. Je nach Level I bis IV bescheinigt sie Grund- und Spezialwissen über Leiterplatten- und Baugruppendesign. Der zertifizierte Abschluss ist ein Nachweis der beruflichen Qualifikation und eine anerkannte Referenz für den Designerberuf.

Intensivkurs ESD-Schutzmanagement in Suttgart-Filderstadt

Im dreitägigen Intensivkurs ESD-Schutzmanagement mit abschließender Prüfung erwerben die Teilnehmer den FED-zertifizierten Abschluss zum ESD-Schutzbeauftragten. „Wirksamer ESD-Schutz ist ein komplexer, viele Bereiche des Unternehmens und seiner Prozesse durchsetzender Vorgang, der als Bestandteil eines bestehenden Qualitätsmanagementsystems gelenkt werden muss“, betont Seminarleiter Michael Günther. Um angemessene ESD-Schutzmaßnahmen an den jeweiligen konkreten Prozessen zu planen und umzusetzen, sein ein Spezialwissen notwendig, das über das allgemeine Fachwissen hinausgeht, so der ESD-Experte Der dreitägige Kurs bietet den Teilnehmern fachlich integere Vermittlung von Spezialwissen, einen hohen Grad an Aktualität und Praxisverbundenheit und verzichtet konsequent auf das Bewerben selektierter ESD-Produkte.

Termin: 7.-9. November in Stuttgart-Filderstadt

ESD-Schutz ist nicht alles, aber ohne geht nichts

Veranstaltungskalender Oktober bis Dezember 2023

9.-11.10.	IPC-A-600 Rev. K Kurs für Spezialisten/CIS, Fulda
9.-11.10.	IPC-A-600 Rev. H Kurs für Trainer/CIT, Fulda
9.-12.10.	IPC-A-610 Rev. H Kurs für Spezialisten, Weimar
9.-13.10.	IPC-A-610 Rev. H Kurs für Spezialisten, Weimar

9.10./10.11.	ZED Level I – Grundlagenkurs Leiterplattendesign, Berlin
16./17.10.	IPC-A-610 Rev. H CIT Rezertifizierung, Weimar
16./17.10.	Seminar: Qualität und Zuverlässigkeit von Leiterplatten und Baugruppen, Berlin
16./17.10.	Elektronikkühlung in Leiterplattendesign und Fertigung (ZED Level IV), Erlangen
17./18.10.	Application and Utilisation of Protective Coatings, online
18.10.	Seminar: Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen, Berlin
18.10.	Qualität im Designprozess (ZED Level IV), Stuttgart-Filderstadt
19.10.	Grundlagen der modernen Baugruppenfertigung (ZED Level IV), Stuttgart-Filderstadt
19.10.	Seminar: Wenn Elektronik brennt, Erlangen
20.10.	Seminar: Der Weg zur abnahmefähigen elektronischen Baugruppe, Berlin
23./24.10.	Seminar: Leiterplattentechnologie in Theorie & Praxis, Erlangen
25.10.	High-Density- Interconnect und Microvias (ZED Level IV), Augsburg
2./3.11.	IPC-A-610 Rev. H Rezertifizierung für Spezialisten/CIS, Erlangen
2./3.11.	IPC-A-610 Rev. H Rezertifizierung für Trainer/CIT, Erlangen
6.11.	High-Power-Baugruppendesign (ZED Level IV), Nürnberg
6.-9.11.	IPC-A-610 Rev. H Kurs für Spezialisten, Erlangen
6.-10.11.	IPC-A-610 Rev. H Kurs für Trainer, Erlangen
7.-9.11.	ESD-Schutzmanagement Intensivkurs, Stuttgart-Filderstadt
13.-16.11.	IPC-A-610 Rev. H Kurs für Spezialisten, Berlin
13.-17.11.	IPC-A-610 Rev. H Kurs für Spezialisten, Berlin
20.-23.11.	IPC/WHMA-A-620 Kurs für Spezialisten, Fulda
20.-24.11.	IPC/WHMA-A-620 Kurs für Trainer, Fulda
20.-24.11.	ZED Level II– Leiterplatten- und Baugruppendesign 1, Berlin
20.-24.11.	IPC/WHMA-A-620 Rezertifizierung/ Prüfung CIS, Fulda
27.11.-1.12.	ZED Level III – Leiterplatten- und Baugruppendesign 2, Berlin
4.-6.12.	IPC-A-600 Rev. K Kurs für Spezialisten/CIS, Berlin
4.-6.12.	IPC-A-600 Rev. H Kurs für Trainer/CIT, Berlin
4.-6.12.	High-Speed-Baugruppendesign (ZED Level IV), Berlin
7.12.	Ionische Kontamination – ROSE Test & Ionenchromatographie
7.12.	Seminar: Signal Integrity Simulation beim PCB-Entwurf, Berlin
8.12.	Seminar: Power Integrity Simulation beim PCB-Entwurf, Berlin
11./12.12.	IPC-A-610 Rev. H Rezertifizierung CIT, Berlin
14./15.12.	EMV-Baugruppendesign (ZED Level IV), Berlin

Impulse und Termine per E-Mail: Der FED-Newsletter

Zweimal im Monat bringt der FED-Newsletter Informationen, Termine und wertvolle Impulse aus der FED-Geschäftsstelle. Der FED-Newsletter kann kostenfrei bestellt werden. Zur Anmeldung geben Sie lediglich Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse unter diesem Link ein: www.fed.de/newsletter. Das Abo kann jederzeit beendet werden.

FED e. V., Frankfurter Allee 73c
10247 Berlin
Tel. +49(0)30 3406030-50
Fax. +49(0)30 3406030-61
http://www.fed.de
email: info@fed.de